

证券代码：688589

证券简称：力合微

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
	<input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 电话会议
	<input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及人员姓名	长信基金	肖文劲
	宁涌富基金	韩洲枫
	中银国际证券	叶志成
	天风证券	李浩时
会议时间	2024年8月7日	
会议地点	公司会议室	
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：夏滨 董办主任、证券事务代表：龚文静	

投资者关系活动主要内容介绍：

一、介绍公司的基本情况和最新经营情况：

公司作为一家芯片设计企业，专注于物联网通信和连接 SoC 芯片，在电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片，并不断加大研发投入、坚持创新、拓展市场应用，为物联网（IoT）、智能家居、光伏新能源等各种数字化、智能化应用场景提供“最后一公里”通信、连接芯片及芯片级完整解决方案，以物联网、新能源、双碳经济、智能家居、数字化转型和智能化升级为市场驱动、以发展自主芯片技术和硬核科技为宗旨，不断提升企业

品牌和发展成为该领域芯片领军企业。2023年，公司实现营业收入 57,918.82 万元，较上年同期增长 14.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,688.66 万元，较上年同期增长 42.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,278.91 万元，较上年同期增长 73.30%。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 12,986.14 万元，同比增长 17.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,335.65 万元，同比增长 9.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,126.14 万元，同比增长 5.54%。

二、解答投资者提问，主要提问及解答如下：

1.在智能家居领域，PLC 技术用于二手房全屋智能改造，会不会存在需要重新布线等问题？

答：PLC 技术在智能家居领域的应用，既可以通过在家用电器设备中内置 PLC 芯片，并在网关上植入芯片来实现通信，也可以采用在适配器/变压器或插座、接线板等设备上内置 PLC 芯片的解决方案。PLC 通过已有电线进行数据传输，无需重新布线，具有穿墙越壁，信号不受阻挡的优势，能够有效实现智能家电的内部控制与通信连接。

2.目前除了华为、力合微等公司对 PLC 智能家居应用的大力推动，还有哪些品牌正在布局 PLC 智能家居？

答：PLC（电力线通信）技术通过华为、力合微等企业在智能家电&全屋智能领域、智能照明等物联网应用市场大力推动下，已经与 WiFi、ZigBee、Bluetooth 等射频无线通信技术共同成为物联网“最后一公里”连接的主流通信技术之一。

在消费类行业应用上，公司持续打造 PLBUS PLC 技术品牌，以“无需布线、有电即通信、低延迟、高可靠性”等特点，经过多年技术营销、品牌营销、市场推广，已获得众多知名企业认可，推动了 PLBUS 电力线载波通信芯片在智能家居应用领域的批量应用，并助力构建开放的智能家居生态。华为全屋智能、AO.SMITH AI-LINK 均采用以 PLC 技术为主的全屋智能设备互联的通信技术，其他企业生态系统也在加速导入 PLC。近期天猫精灵推出的全屋智能产品方案就是采用了 PLC 技术、由小米发起的全屋互联开放联盟（HCOA）也在积极推动有

线 PLC 技术标准的统一，以 PLC 通信技术为家居全屋智能的主要连接技术态势正在形成。

3.在智能电网市场，公司芯片在低压配网创新应用是否属于新的增长点？

答：公司在既有市场的基础上，拓宽应用领域，顺应电网公司智能化、数字化发展的政策，在电力设备万物互联的大趋势下，积极开发应用于低压配网市场的新产品，用于低压配网创新应用的通信单元、量测单元和中继器等新产品已实现了批量供货。随着国家电网对电网智能化及配网自动化的进一步改造，需要更多的终端设备增加远程控制及通信功能，比如智能断路器、智能开关等等，相较于原来只是智能电表的控制，未来通过电力线技术来连接的节点会更广泛，智能电网领域的市场总量将大幅提升。

4.公司芯片产品的存货压力怎么样？

答：公司不断加强供应链体系的管理，加快存货周转，2023 年公司基于自研芯片及核心技术的产品库存量较上年减少了 49.62%，存货压力较小；公司芯片产品均为自主设计开发，在晶圆厂的选择上有较大的自主权，无论在价格、交货期、增量需求等各个方面都展现出了较强的竞争优势；此外，公司通过及时了解市场供应状况，及时向芯片合作厂商提供预计订量，提前预留产能，有效地保证了公司芯片的供应，能够满足市场的需求。

5.公司今年考虑下修转股价格吗？

答：公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，董事会决定自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日期间不向下修正“力合转债”的转股价格。若再次触发“力合转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“力合转债”的转股价格。